



2024年12月4日

各位

会社名 株式会社TMH  
代表者名 代表取締役社長 榎並 大輔  
(コード：280A 東証グロース 福証Q-Board)  
問合せ先 取締役経営管理部長 関 真希  
(TEL. 097-576-7666)

## 東京証券取引所グロース市場および福岡証券取引所Q-Boardへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ

当社は、本日2024年12月4日に東京証券取引所グロース市場および福岡証券取引所Q-Boardに上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、2024年11月期（2023年12月1日から2024年11月30日）における当社の業績予想は、以下のとおりであります。

また、最新の決算情報等につきましては別添のとおりであります。

### 【個別】

(単位：百万円、%)

	2024年11月期 (予想)			2024年11月期 第3四半期累計期間 (実績)		2023年11月期 (実績)	
	対売上 高比率	対前期 増減率		対売上 高比率		対売上 高比率	
売上高	6,235	100.0	256.9	3,885	100.0	1,747	100.0
営業利益又は 営業損失(△)	361	5.8	—	61	1.6	△127	—
経常利益又は 経常損失(△)	359	5.8	—	29	0.8	△353	—
当期(四半期)純利益	286	4.6	145.6	28	0.7	116	6.7
1株当たり当期(四半期) 純利益	85円04銭			8円36銭		34円89銭	
1株当たり配当金	0円00銭			0円00銭		0円00銭	

- (注) 1. 当社は、連結決算財務諸表および四半期連結財務諸表を作成しておりません。
2. 2023年11月期(実績)および2024年11月期第3四半期累計期間(実績)の1株当たりの当期(四半期)純利益は期中平均株式数により算出しております。なお、当社は、基準日(2024年11月30日)を超えての新株式発行となることから、2024年11月期(予想)において、発行済株式総数の増加は見込んでおりません。
3. 当社が発行していた種類株式について、その株式の内容より「普通株式と同等の株式」として取り扱っていたことから、1株当たり四半期純利益の算定上、普通株式に含めて算定しております。なお、種類株式のすべてについて、取得請求権の行使により、2024年7月1日付で自己株式として取得し、その対価として種類株式1株につき、普通株式1株を交付し、取得した種類株式を同日付ですべて消却いたしました。
4. 当社は、2024年7月31日付で普通株式1株につき250株の株式分割を行っております。上記では、2023年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期(四半期)純利益を算出しております。

## 【2024年11月期業績予想の前提条件】

### 1. 当社全体の見通し

当社は、「Technology Makes Happiness」の頭文字を社名に採用し、「先端技術で豊かな社会を創る」ことをミッションとして掲げています。

日本の半導体産業の復活に貢献し、お客様にとって最良のパートナーとなることで、豊かな社会の実現を目指しています。

主な事業として、半導体工場向けに半導体製造装置や部品の販売および修理サービス、さらには中古半導体製造装置の買取・売却支援を行っています。

当社は、情報力とエンジニアリング力の両輪からこれらのサービスを強化し、半導体工場の多様なニーズに応えています。特に、越境ECサイト「LAYLA-EC」（以下、「LAYLA-EC」といいます。）などを活用した部品販売や修理サービスでは、世界中のサプライヤーから部品を調達し、迅速かつ効率的に各工場に供給することで、半導体工場の稼働効率向上に寄与しています。

また、中古装置の買取・売却支援においては、技術営業やフィールドエンジニア（FE）の専門知識を活かし、装置の解体、搬出、設置、プロセスチューニングなど、高度なエンジニアリングサービスを提供しています。

半導体は、日常の電化製品から電気自動車、生成AIに至るまで、あらゆるテクノロジーに不可欠な存在です。世界の半導体市場は2030年には1兆ドル規模に達すると予測されています。その中で、当社の属するアフターマーケット市場も拡大傾向にあり、老朽化する半導体工場の需要が高まっています。2021年に2.7兆円であったアフターサービス市場規模は、2024年には4.1兆円に成長する見込みです。また、中古半導体製造装置市場も拡大しており、2023年には推定3.8兆円（1ドル=160円換算）規模に達しています。

このような状況のもと、2024年11月期の業績予想は、売上高6,235百万円（前期比256.9%増）、営業利益361百万円（前期は営業損失127百万円）、経常利益359百万円（前期は経常損失353百万円）、当期純利益286百万円（前期比145.6%増）を見込んでおります。

### 2. 業績予想の前提条件

本資料に記載の2024年11月期の業績予想数値は、2024年5月までの実績値に2024年6月以降の予想数値を合算して算出した数値となっております。なお、2024年6月以降の予想数値と実績数値とに大きな差異は生じておりません。

なお、当社は、半導体製造フィールドソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

#### （1）売上高

当社の売り上げ構造は主に以下の2つのパターンに分類されます。

（越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス）

越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービスの売上高は、「LAYLA-EC」を通じて安定的な調達経路を確立し、また、国内外の幅広いサプライヤーとの連携をすることで部品および修理サービスを提供することによる売上から成り立っております。2024年11月期の売上については、2024年5月までの実績値に2024年6月以降の顧客別の売上予測をこれまでの実績を加味し、見込んで策定しております。

以上の結果、2024年11月期の越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービスの売上高は、987百万円（前期比5.4%増）を見込んでおります。

（エンジニアリング力を活用した装置販売サービス）

エンジニアリング力を活用した装置販売サービスの売上高は、当社の技術営業人員が国内外のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業することで、前工程を中心とした半導体製造装置に関して様々なソリューション（半導体製造装置の解体・販売・据え付けなど）を提供することによる売上から成り立っております。2024年11月期の売上については、2024年6月以降の大型案件の顧客の検収時期を見込んで策定しており、2024年11月期の出荷台数につきましては、64台（2023年11月期実績：21台）を計画しております。

以上の結果、エンジニアリング力を活用した装置販売サービスの売上高は、5,247百万円（前期比547.5%増）を見込んでおります。

以上を踏まえ、当社全体の2024年11月期売上高は、6,235百万円（前期比256.9%増）を計画しております。

なお、2024年11月期第3四半期累計期間の売上高実績は3,885百万円であります。部品販売・修理サービスおよび装置販売サービスの受注および役務提供が順調に増加しており、売上高の予想値通りで進捗しております。

#### （2）売上原価、売上総利益

売上原価は、販売する半導体製造装置および部品の仕入れおよび修理コストならびに顧客への役務提供に直接関与する労務費および配送費等から構成されております。

2024年6月～2024年11月までの売上原価の計画につきましては、売上高と同様にサービス別、顧客別および案件別に見積もって積み上げ方式にて算出しております。

以上から、2024年11月期における売上原価は、5,344百万円（前期比280.0%増）、売上総利益は890百万円（前期161.3%増）を計画しております。

なお、2024年11月期第3四半期累計期間の売上原価は3,441百万円、売上総利益は443百万円、売上総利益率は11.4%であります。

#### （3）販売費及び一般管理費、営業利益

販売費及び管理費は、主に人件費・採用教育費・業務委託料・旅費交通費・管理諸費で構成されております。

そのうち人件費（307百万円）（前期比6.5%増）は販売費及び一般管理費の全体の58.1%を占めており、人員計画等に基づいて算出しております。

採用教育費（14百万円）は主にリクルートエージェント費用であります。当社は半導体の知識を有したバイリンガル人材を積極的に採用しております。

業務委託料（32百万円）は一部業務を外部に委託していることによる費用であります。少人数での従業員のリソースを最大限生かすために、外部委託できる業務について活用しております。

管理諸費（26百万円）は主に監査報酬であります。

旅費交通費（34百万円）は営業活動のための国内外への出張旅費であります。当社は販売先および仕入先を問わず外国企業との取引も多いためであります。

以上から、2024年11月期における販売費及び一般管理費は、528百万円（前期比13.0%増）、営業利益は361百万円（前期は営業損失127百万円）を計画しております。

なお、2024年11月期第3四半期累計期間の販売費及び一般管理費は381百万円、営業利益は61百万円であります。営業利益の予想値については、現段階で想定通りの推移となっております。

#### （4）営業外損益、経常利益

営業外収益（29百万円）は、主に為替差益と補助金収入であり、2024年5月までの実績値であります。

また、営業外費用（31百万円）は、主に上場関連費用であります。

以上から、2024年11月期の経常利益は359百万円（前期は経常損失353百万円）を計画しております。

なお、2024年11月期第3四半期累計期間の営業外損益は△32百万円、経常利益は29百万円であります。経常利益の予想値については、現段階で想定通りの推移となっております。

#### （5）特別損益、法人税等、当期純利益

特別利益および特別損失につきましては計画をしておりません。

また、法人税等につきましては、当事業年度において税務上の繰越欠損金がすべて解消され、翌事業年度においても一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれることから、27百万円の繰延税金資産の計上（法人税等調整額のマイナス）を見積もっております。

以上から、2024年11月期の当期純利益は286百万円（前期比145.6%増）を計画しております。

なお、2024年11月期第3四半期累計期間の四半期純利益は28百万円であります。

**【業績予測に関するご留意事項】**

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上



## 2024年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2024年12月4日

上場会社名 株式会社TMH 上場取引所 東福  
 コード番号 280A URL <https://www.tmh-inc.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 榎並 大輔  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理部長 (氏名) 関 真希 TEL 097 (576) 7666  
 配当支払開始予定日 —  
 決算補足説明資料作成の有無：無  
 決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年11月期第3四半期の業績（2023年12月1日～2024年8月31日）

#### (1) 経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年11月期第3四半期	3,885	—	61	—	29	—	28	—
2023年11月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年11月期第3四半期	8.36	—
2023年11月期第3四半期	—	—

- (注) 1. 2023年11月期第3四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、2023年11月期第3四半期の数値および前年同四半期増減率ならびに2024年11月期第3四半期の前年同四半期増減率については記載しておりません。
2. 当社が発行していた種類株式について、その株式の内容より「普通株式と同等の株式」として取り扱っていたことから、1株当たり四半期純利益の算定上、普通株式に含めて算定しております。なお、種類株式のすべてについて、取得請求権の行使により、2024年7月1日付で自己株式として取得し、その対価として種類株式1株につき、普通株式1株を交付し、取得した種類株式を同日付ですべて消却いたしました。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
4. 当社は、2024年7月31日付で普通株式1株につき250株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

#### (2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円		百万円		%
2024年11月期第3四半期	3,596		537		14.9
2023年11月期	1,697		509		30.0

(参考) 自己資本 2024年11月期第3四半期 537百万円 2023年11月期 509百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年11月期	—	—	—	0.00	0.00
2024年11月期	—	—	—	—	—
2024年11月期（予想）	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 2024年11月期の業績予想（2023年12月1日～2024年11月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	6,235	256.9	361	—	359	—	286	145.6	85.04

- (注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
2. 当社が発行していた種類株式について、その株式の内容より「普通株式と同等の株式」として取り扱っていたことから、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて算定しております。なお、種類株式のすべてに

- ついて、取得請求権の行使により、2024年7月1日付で自己株式として取得し、その対価として種類株式1株につき、普通株式1株を交付し、取得した種類株式を同日付ですべて消却いたしました。
3. 当社は、2024年7月31日付で普通株式1株につき250株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
② ①以外の会計方針の変更 : 無  
③ 会計上の見積りの変更 : 無  
④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年11月期3Q	3,366,250株	2023年11月期	3,366,250株
② 期末自己株式数	2024年11月期3Q	一株	2023年11月期	一株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年11月期3Q	3,366,250株	2023年11月期3Q	一株

- (注) 1. 当社は、2023年11月期第3四半期において、四半期財務諸表を作成していないため、2023年11月期第3四半期の「期中平均株式数」は記載しておりません。
2. 当社が発行していた種類株式について、その株式の内容より「普通株式と同等の株式」として取り扱っていたことから、普通株式に含めております。なお、種類株式のすべてについて、取得請求権の行使により、2024年7月1日付で自己株式として取得し、その対価として種類株式1株につき、普通株式1株を交付し、取得した種類株式を同日付ですべて消却いたしました。
3. 当社は、2024年7月31日付で普通株式1株につき250株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」および「期中平均株式数」を算定しております。

※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況 .....	2
(1) 当四半期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当四半期の財政状態の概況 .....	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期貸借対照表 .....	3
(2) 四半期損益計算書 .....	4
(第3四半期累計期間) .....	4
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 .....	5
(セグメント情報等の注記) .....	5
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	5
(継続企業の前提に関する注記) .....	5
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....	5

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期累計期間(2023年12月1日～2024年8月31日)におけるわが国経済は、継続的な円安基調によりグローバルメーカーを中心として業績が回復し、日経平均株価が1989年以来の最高値を更新するなど、経済に明るい兆しがみられ始めました。

特にAI半導体メーカーのエヌビディアの好決算、パワー半導体の需要旺盛、メモリ市況の回復など半導体業界にも明るいニュースが多く、株式市場の好調を半導体関連銘柄が下支えいたしました。

このような状況の中、当社の第3四半期累計期間の売上高は期初の計画を上振れして推移しております。

半導体製造フィールドソリューション事業では、半導体工場からの装置の解体および搬出を伴う案件が大幅に増加し、エンジニアリング能力が強く求められました。さらに、従来から展開してきた当社越境ECサイト「LAYLA-EC」に加え、半導体メーカーのデジタル化を加速させる新たな競売プラットフォームシステム「LAYLA-Auctionの本格的な営業展開により引き合いが増加しつつあります。

プラットフォームとエンジニアリングの二つの柱を軸にした事業展開が、更なる業績拡大に貢献していくものと考えております。

この結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高3,885,264千円、営業利益61,627千円、経常利益29,259千円、四半期純利益28,145千円となりました。

なお、当社は半導体製造フィールドソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

### (2) 当四半期の財政状態の概況

#### (資産)

当第3四半期会計期間末における資産は3,596,966千円となり、前事業年度末に比べ1,899,678千円増加いたしました。これは主に、営業キャッシュ・フローの獲得等に伴い現金及び預金が増加したことならびに大型装置販売のための仕入に伴う未収還付消費税等が増加したことによるものであります。

#### (負債)

当第3四半期会計期間末における負債は3,059,558千円となり、前事業年度末に比べ1,871,532千円増加いたしました。これは主に、大型装置販売に係る前受金の受領に伴い契約負債が増加したことによるものであります。

#### (純資産)

当第3四半期会計期間末における純資産合計は537,408千円となり、前事業年度末に比べ28,145千円増加いたしました。これは、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

### (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年11月期の業績予想につきましては、本日開示しました「東京証券取引所グロース市場および福岡証券取引所Q-B o a r dへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」をご参照下さい。

なお、当該業績予想につきましては、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。



2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年11月30日)	当第3四半期会計期間 (2024年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,074,636	2,547,383
売掛金	93,628	142,107
商品	235,195	333,389
その他	178,097	340,316
流動資産合計	1,581,556	3,363,197
固定資産		
有形固定資産	96,372	216,220
無形固定資産	3,265	1,735
投資その他の資産	16,092	15,812
固定資産合計	115,730	233,768
資産合計	1,697,287	3,596,966
負債の部		
流動負債		
買掛金	377,136	248,728
契約負債	505,466	2,407,080
賞与引当金	—	24,570
その他	125,651	197,132
流動負債合計	1,008,255	2,877,512
固定負債		
長期借入金	179,770	182,046
固定負債合計	179,770	182,046
負債合計	1,188,025	3,059,558
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	93,920	93,920
利益剰余金	315,342	343,488
株主資本合計	509,262	537,408
純資産合計	509,262	537,408
負債純資産合計	1,697,287	3,596,966

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年8月31日)
売上高	3,885,264
売上原価	3,441,967
売上総利益	443,297
販売費及び一般管理費	381,669
営業利益	61,627
営業外収益	
受取利息	2,787
補助金収入	13,753
その他	145
営業外収益合計	16,686
営業外費用	
支払利息	3,240
売上債権売却損	1,977
為替差損	42,335
固定資産圧縮損	1,478
その他	22
営業外費用合計	49,054
経常利益	29,259
税引前四半期純利益	29,259
法人税、住民税及び事業税	1,113
法人税等合計	1,113
四半期純利益	28,145

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社は、半導体製造フィールドソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

---

当第3四半期累計期間  
(自 2023年12月1日  
至 2024年8月31日)

---

減価償却費

7,179千円